ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Установка шлифовки и полировка пластин EVG-300

Цена:

Цена по запросу

Описание

Установка шлифовки и полировки пластин EVG-300 обеспечивают обработку полупроводниковых пластин и подложек диаметром до 300 мм на основе таких материалов как кремний (Si), германий (Ge), карбид кремния (SiC), арсенид галлия (GaAs), нитрид галлия (GaN), нитрид алюминия (AlN), фосфид индия (InP), сапфир, керамика, стекло, титан, сталь. Загрузка подложек осуществляется оператором вручную, а процесс утонения автоматически согласно заданному рецепту. Помимо поштучной обработки, доступна возможность групповой обработки подложек, закреплённых на временном носителе диаметром до 300 мм. Установка EVG-300 оснащается специальными шлифовальными/полировальными дисками Engis на основе технологии MAD (Mixed Abrasive Diamond), которая адаптирует спецификацию диска к типу обрабатываемого материала для достижения оптимальной плоскостности, шероховатости и исключает необходимость использования дополнительного оборудования. Компактные габаритные размеры в сочетании с широкими функциональными возможностями установки шлифовки и полировки EVG-300 соответствуют современным требованиям мелкосерийного производства или научно-исследовательских лабораторий.

Возможны бесплатные тесты шлифовки и полировки в лаборатории производителя на образцах заказчика.

00 мм с 840 мкм до 147 мкм с использованием шлифовальных/полировальных дисков Engis

Рис.1. Пример утонения пластины SiC Ø100 мм с 840 мкм до 147 мкм с использованием шлифовальных/полировальных дисков Engis.

Технические характеристики

Модель	EVG-300
Загрузка	Ручная

Тип обработки	Одиночная или групповая
Материал подложек	Si, Ge, SiC, GaAs, GaN, AlN, InP, сапфир, керамика, стекло, металлы
Размер образца	Пластины диаметром до 300 мм, групповые заготовки Прямоугольные подложки до 212×212 мм
Толщина образца	До 50 мм
Размер рабочего стола	Ø300 мм
Размер шлифовального диска	Ø305мм
Мощность привода	5 кВт
Возможность проводить процессы шлифовки и полировки при помощи сменных дисков	Наличие
Скорость вращения рабочего стола	Макс. 400 об/мин (CW и CCW вращение)
Мощность привода стола	1.5 кВт
Скорость вращения шлифовального диска	Макс. 2000 об/мин (CW и CCW вращение)
Мин. скорость подачи	6 мкм/мин (0.6 мкм/с) Опционально 0.6 мкм/мин (0.01 мкм/с)
Макс. скорость подачи	600 мкм/мин (10 мкм/с)
Управление	Промышленный ПЛК (Mitsubishi / Keyence) Цветной сенсорный дисплей 7.4" Независимой контроль скорости вращения стола и диска Светозвуковая колонна типа «светофор» 3 уровня доступа (оператор, наладчик, технолог)
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	1050×1050×2020 мм
Вес	1200 кг
Питание	380 В, 50 Гц, 3ф.

Сжатый воздух	0.5 – 0.8 МПа
Дополнительные опции	Встроенная станция заточки рабочего диска Встроенная система контроля толщины пластин